

NISSOCURE

TIC-188



日本曹達株式会社

化学品事業部機能化学品部機能材料課

包接技術とは？

分子(ホスト)が形成する結晶空間に別の分子(ゲスト)を分子単位で閉じ込めるものです。

包接触媒

包接技術を用い、イミダゾール類を結晶空間に閉じ込めました。

これら、包接された触媒は特徴あるエポキシ硬化挙動を示します。

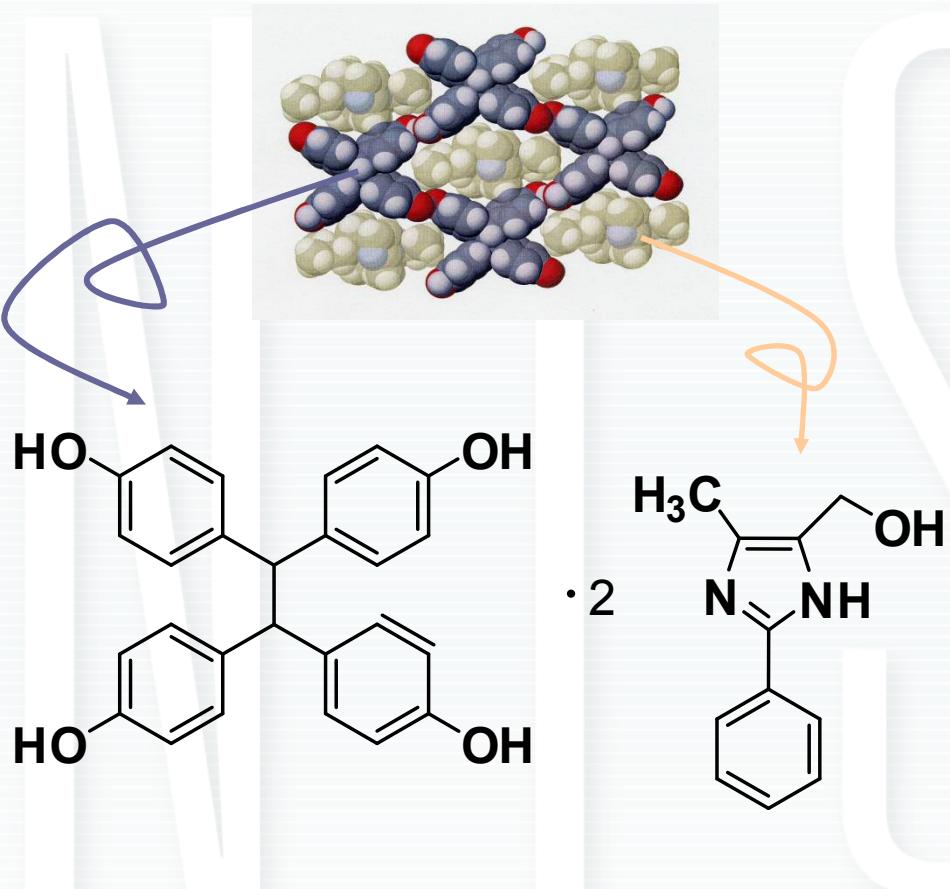
効果

- ・常温での触媒活性を抑制
- ・ポットライフの向上
- ・流動性の向上

用途

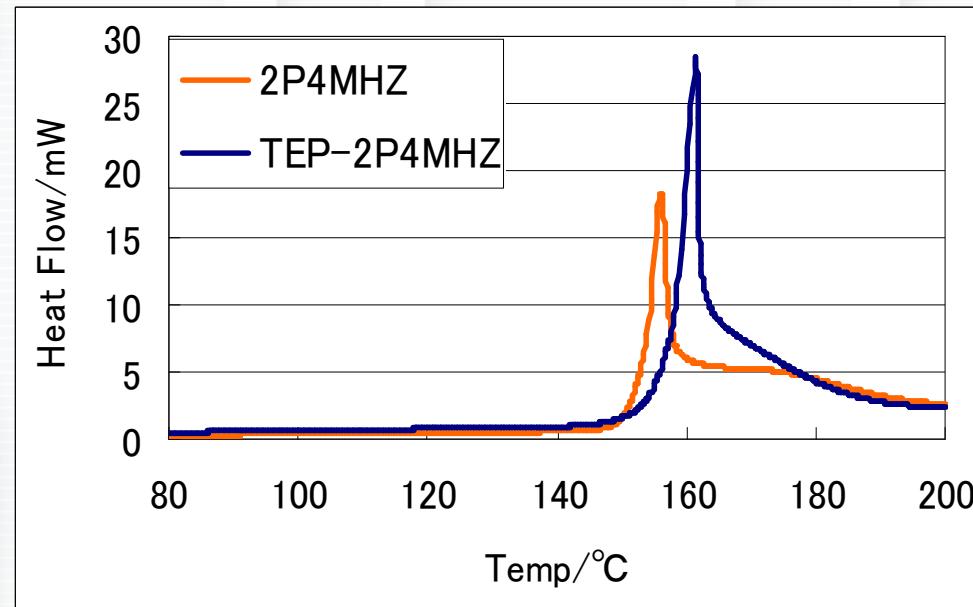
- ・半導体封止材
- ・絶縁材
- ・接着剤
- ・その他エポキシ樹脂硬化用途

TIC-188



【DSC測定組成】

液状エポキシ樹脂:100 硬化触媒(2P4MHZとして):4



NISSOCURE TIC-188の効果

【組成】

o-クレゾールノボラックエポキシ樹脂:100

ノボラックフェノール型硬化剤:50

離型剤:2

シランカップリング剤:5

球状シリカ:900

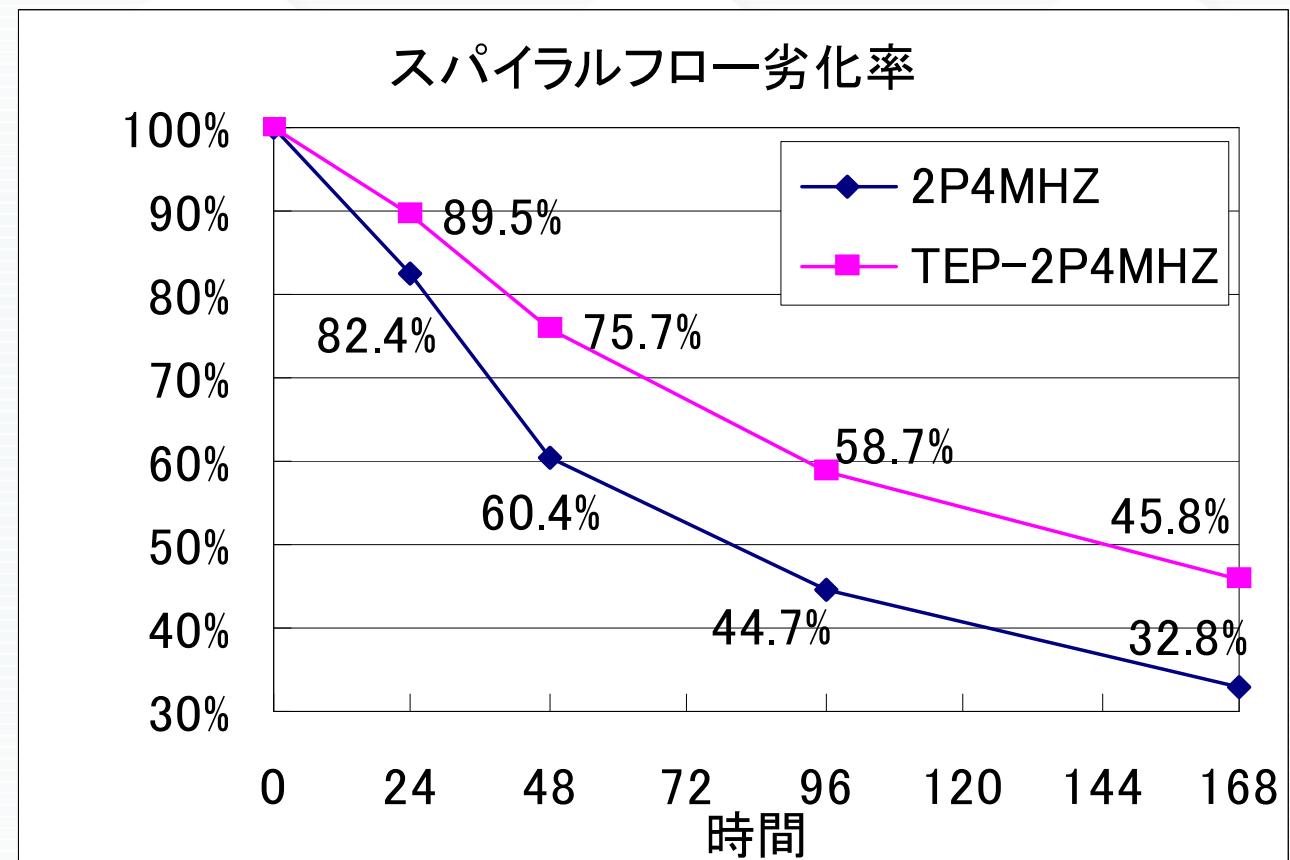
硬化触媒(2P4MHZとして):2

【保存試験温度】 25°C

【成形条件】

175°C × 70kgf/cm² × 3分間

トランスファーラム速度 5cm/sec



お問い合わせ先



ご興味がございましたら下記までお問合せください

日本曹達株式会社 化学品事業部
機能化学品部機能材料課

東京都千代田区大手町2-2-1
TEL: 03-3245-6203
FAX: 03-3245-6277